

# Henkel AG & Co. KGaA のはんだ材料事業に係る 商権・資産等、買収完了のお知らせ（補足資料）

ハリマ化成グループ株式会社

# 買収の概要



買収の内容	<ul style="list-style-type: none"><li>• Henkel AG &amp; Co. KGaA(以下ヘンケル社)の「はんだ材料事業」に関連する資産の購入</li><li>• 工場従業員、研究/技術営業スタッフ90名の移籍</li><li>• 資産購入後、ヘンケル社がハリマの事業立ち上げを支援</li></ul>
主要製品	<ul style="list-style-type: none"><li>• ソルダペースト（ペースト状はんだ）、やに入りはんだ アクセサリー（はんだ製品関連の薬剤等）</li></ul>
買収完了日	2022年6月1日
買収価格	ヘンケル社との契約により非開示

# 買収の目的



シェア拡大、顧客基盤の拡大

グローバル市場での競争力強化

製品ラインアップの拡大

事業規模拡大による生産効率アップ



# 買収後の はんだ事業 グローバルネットワーク



開発/技術営業拠点



(英国)  
Harima UK Ltd  
新設

(中国)  
杭州哈利瑪電材技術有限公司

(米国)  
Harimatec Inc.

(チェコ)  
Harimatec Czech,  
S.r.o.

(日本)  
ハリマ化成(株)  
日本フィラーメタルズ(株)

(マレーシア)  
Harimatec Malaysia  
Sdn.Bhd.  
イポー工場買収で2工場体制に



イポー工場

# 買収で取得した製品群の特長

製品	特長
高信頼性ソルダペースト (品名：90iSC)	はんだ接合部の耐久力向上、自動車部品メーカー向け主力商品。
ハロゲンフリーソルダペースト	EUの環境規制に対応（RoHS、REACH）。
室温保管可能ソルダペースト (品名：GC)	室温で1年間保管可能。保管コスト削減、カーボンニュートラル対応。
ディスペンスソルダペースト	電子機器小型化による製造工法変更対応。

製品ラインナップ拡充、技術統合により販売強化

# 電子材料事業の成長戦略



当社の電子材料事業カンパニーは、自動車の電動化/自動運転、5G、DX（Digital transformation）などを支える、はんだ材料、半導体用機能性樹脂、ろう付け材料などの事業拡大を追求します。

今回買収したはんだ材料事業も、2026年度までの中期経営計画「New Harima2026」の成長戦略の重要な構成要素となっています。

電子材料事業の成長戦略

